

2025年3月期上期

決算説明会資料

2024年11月14日



株式会社 メイコー
(証券コード：6787)

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争等様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2025年3月期上期実績

2

2025年3月期通期予想

3

企業価値向上の取組

4

新規事業の取組

2025年3月期上期 業績

(単位：億円)

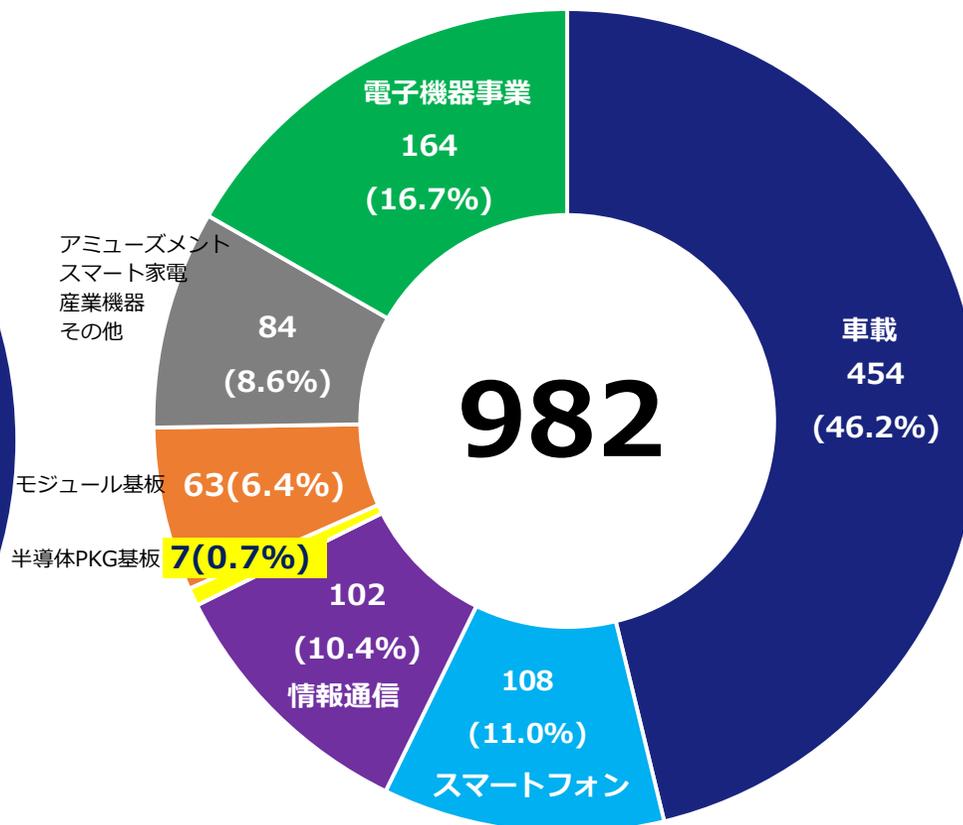
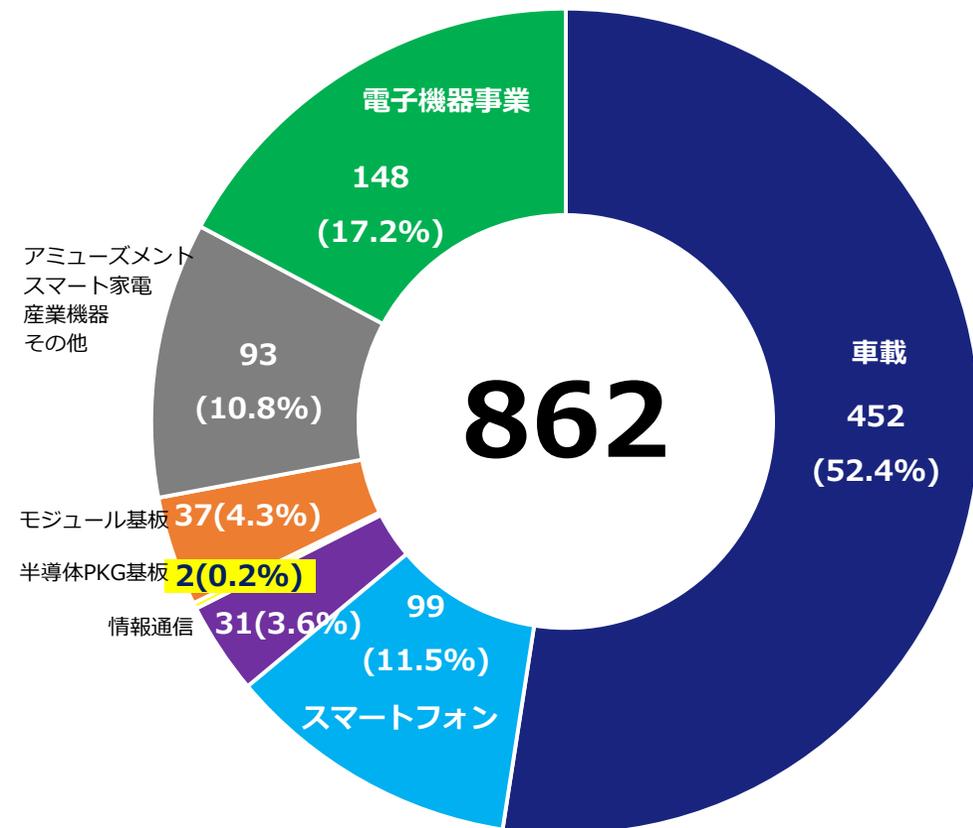
	2024年3月期 上期実績	2025年3月期 上期実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	862	982	120	13.8%
営業利益	42 4.9%	93 9.5%	51	121.3%
経常利益	68 7.8%	80 8.2%	12	18.4%
当期純利益	52 6.0%	63 6.5%	11	21.3%
期中平均為替レート (JPY/USD)	142.61	152.46		
1株当たり配当金	27円	40円		

2025年3月期上期 商品別実績

(単位：億円)

2024年3月期上期

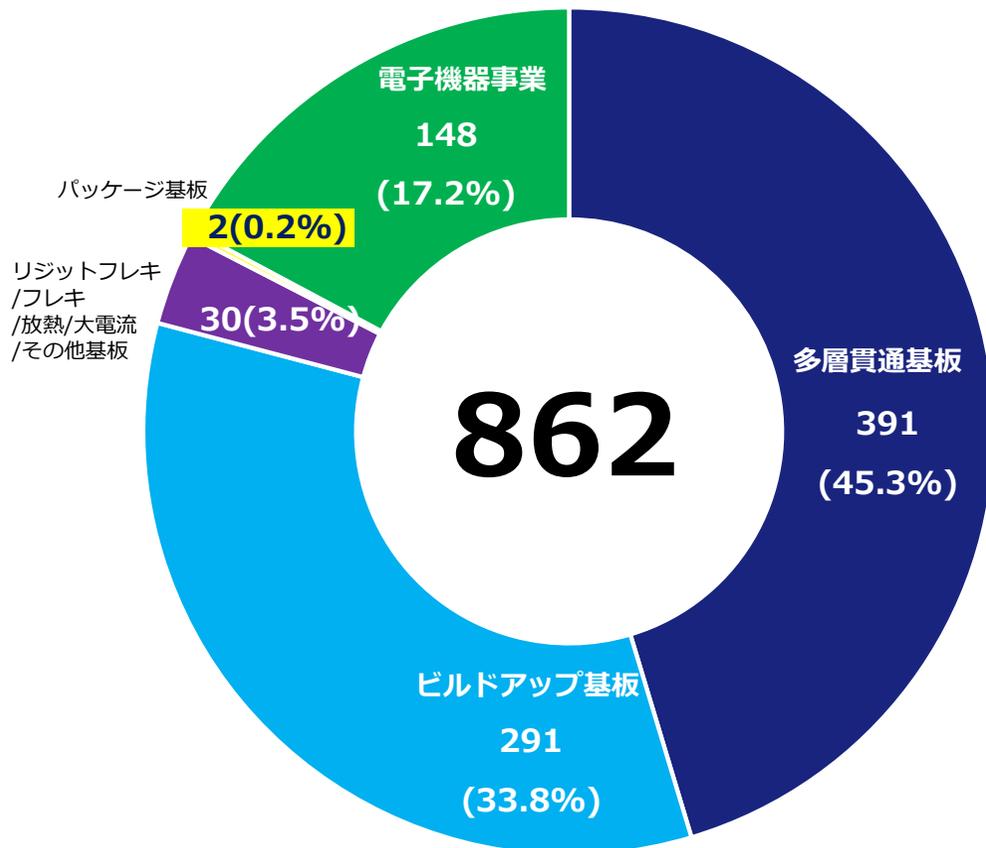
2025年3月期上期



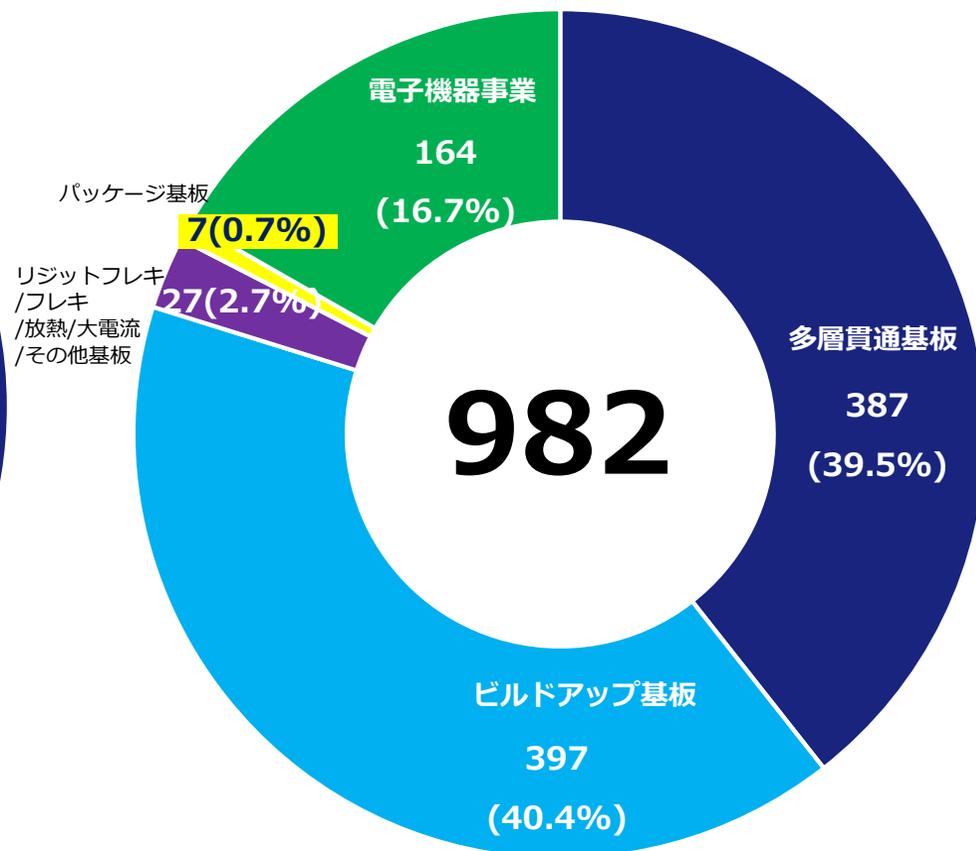
2025年3月期上期 仕様別実績

(単位：億円)

2024年3月期上期



2025年3月期上期



1

2025年3月期上期実績

2

2025年3月期通期予想

3

企業価値向上の取組

4

新規事業の取組

2025年3月期 下期予想/通期予想

(単位：億円)

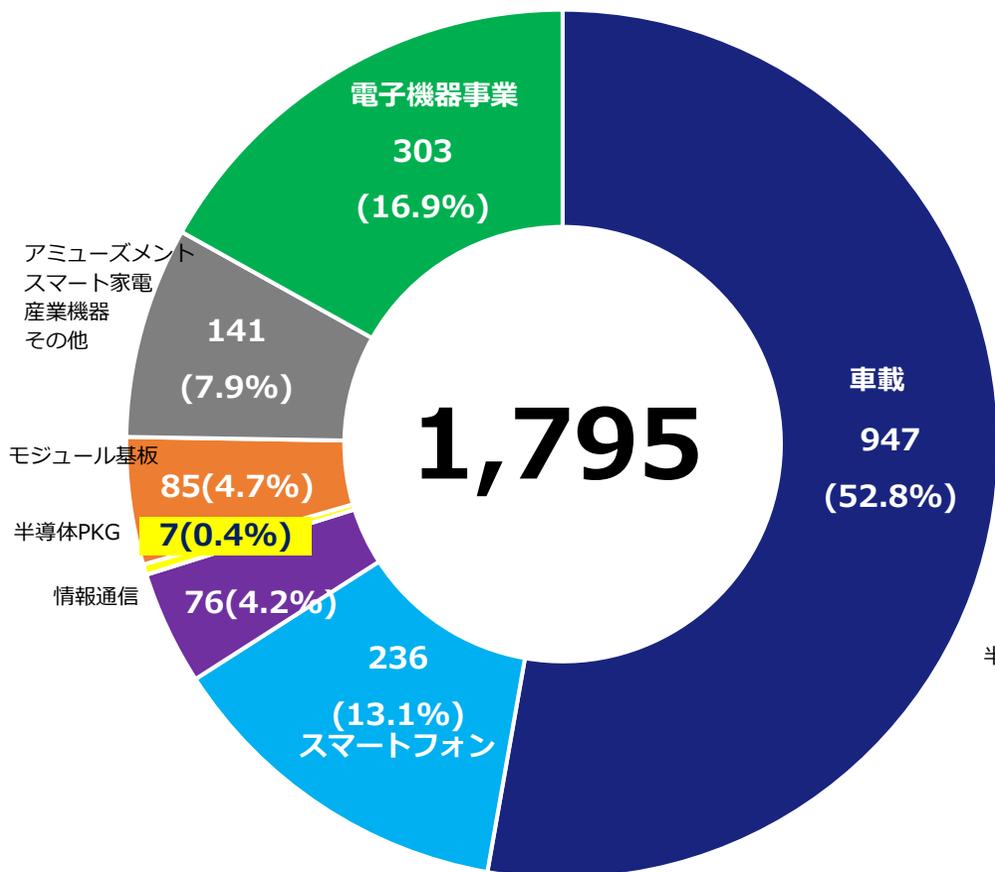
	2024年3月期 通期実績	2025年3月期 下期予想	2025年3月期 通期予想	前年比	
				増減額	増減率
売上高	1,795	988	1,970	175	9.8%
営業利益	117 6.5%	97 9.8%	190 9.6%	73	62.9%
経常利益	143 8.0%	95 9.6%	175 8.9%	32	22.7%
当期純利益	113 6.3%	87 8.8%	150 7.6%	37	32.6%
期中平均為替レート (円/USD)	145.30	145	148.73		
配当	68円	40円	80円		

今期は、売上～純利益と配当80円で過去最高を目指す

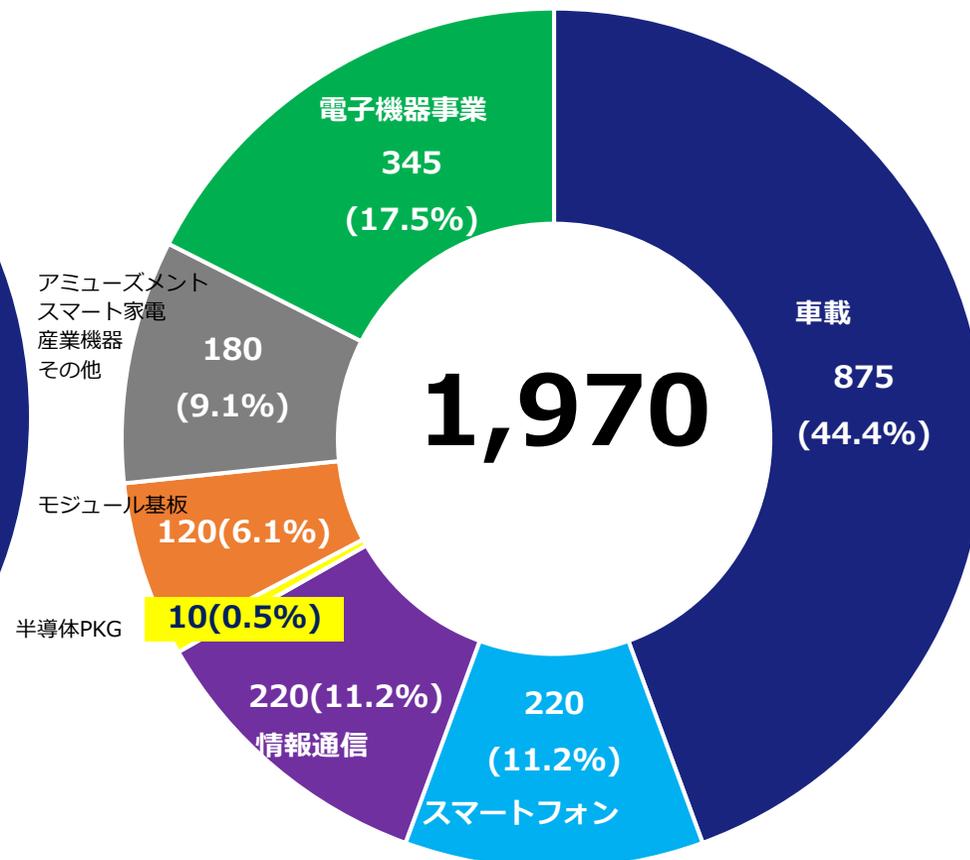
商品別売上高シェア

(単位：億円)

2024年3月期通期実績

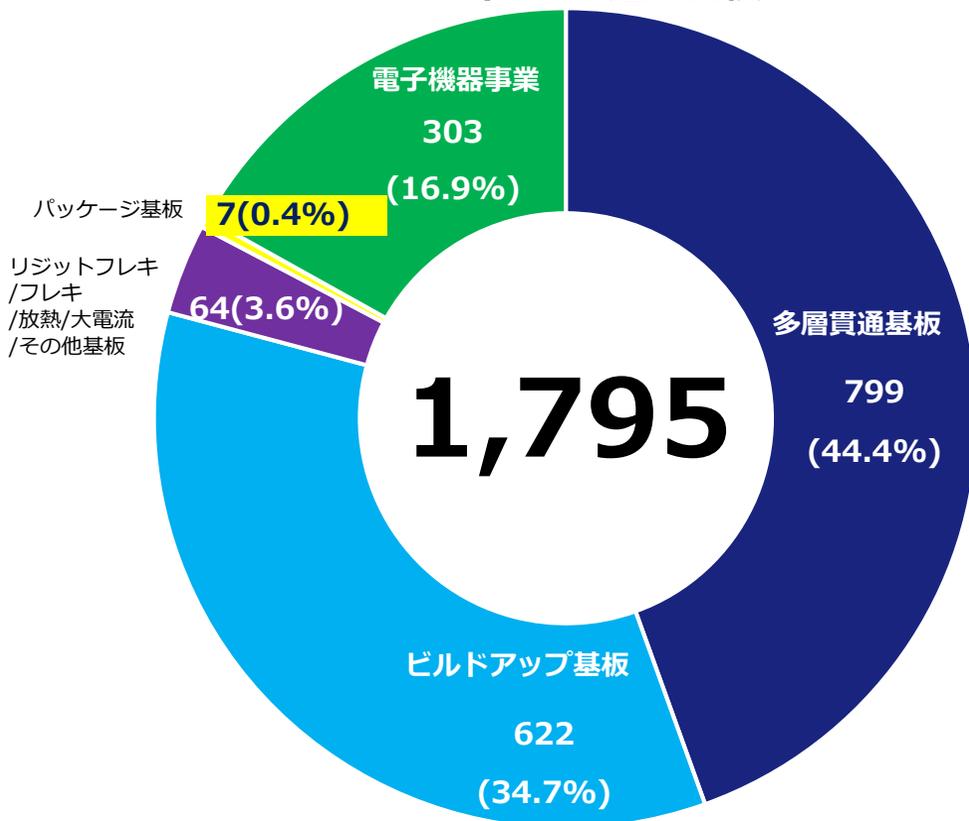


2025年3月期通期予想

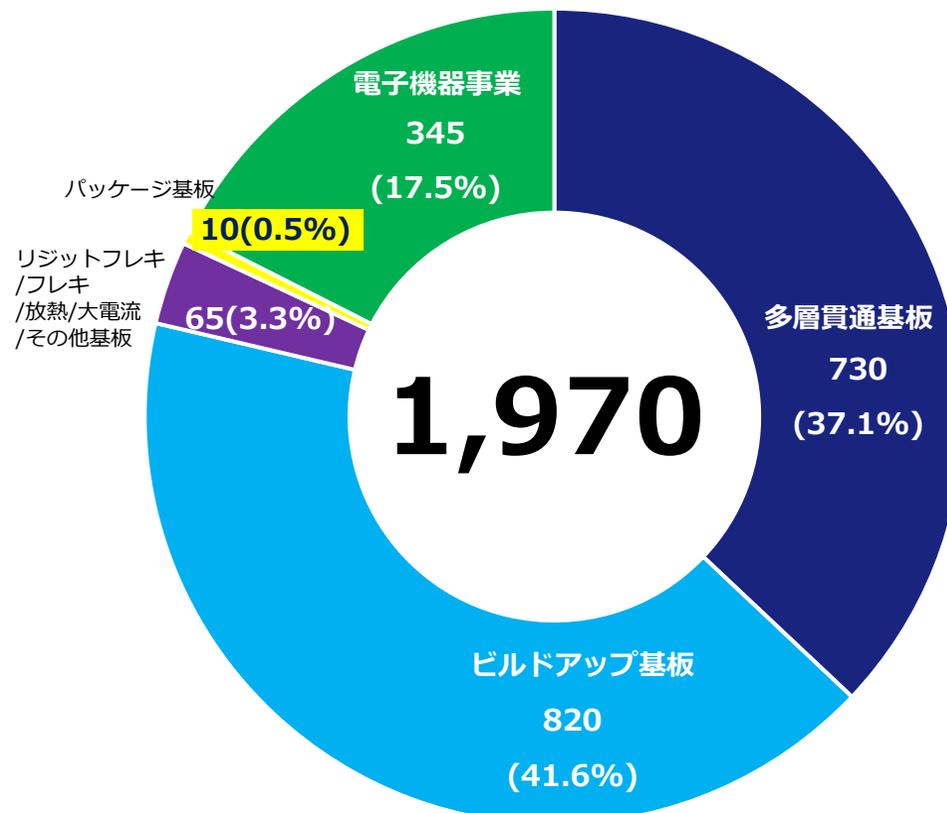


車載は前年比大幅ダウン

2024年3月期通期実績



2025年3月期通期予想



1. 多層貫通基板は前年比大幅ダウン、ビルドアップ基板は大幅アップ。
2. 投資はこの5年で924億円。大半をビルドアップ基板向けに投資。これが結実した。
3. 今後は高精細、高多層、高速化基板に投資を行う。

1

2025年3月期上期実績

2

2025年3月期通期予想

3

企業価値向上の取組

4

新規事業の取組

企業価値向上の取組

(単位：億円)

1. 設備・研究開発投資を通じ、継続的に売上高・利益を拡大させて行きます。
2. バランスの取れた財務体質の強化を進めて参ります。
3. 連結配当性向は15%を目安とします。
4. 利益を拡大させ、株主価値と配当額の向上に努めます。

	2021年3月期実績	2022年3月期実績	2023年3月期実績	2024年3月期実績	2025年3月期予想	2025年/2021年
売上高合計	1,193	1,513	1,673	1,795	1,970	1.7倍
営業利益	67	133	96	117	190	2.8倍
営業利益率(%)	5.6%	8.8%	5.7%	6.5%	9.6%	1.7倍
当期純利益	46	115	88	113	150	3.3倍
投資額	107	144	174	199	300	2.8倍
研究開発費	14	30	45	53	55	3.9倍
EBITDA	141	213	197	228	318	2.3倍
純資産合計	406	587	845	1,054	1,130	2.8倍
自己資本比率	28.5%	34.7%	38.2%	42.7%	42.6%	1.5倍
ROE	11.4%	19.5%	10.5%	10.7%	13.4%	1.2倍
株価	2,687円	4,055円	2,922円	5,420円	8,290円*	3.1倍
時価総額	720	1,087	783	1,453	2,222*	3.1倍
PER	15.08倍	9.08倍	8.47倍	12.29倍	14.18倍*	0.9倍
PBR	1.73倍	1.78倍	0.97倍	1.32倍	2.20倍*	1.3倍
配当額	20円	45円	55円	68円	80円	4倍
配当性向	11.3%	10.1%	16.2%	15.9%	13.7%	

*は11月11日現在

1

2025年3月期上期実績

2

2025年3月期通期予想

3

企業価値向上の取組

4

新規事業の取組

新規事業の取組 パッケージ基板

(単位：億円)

生産拠点

石巻第2工場

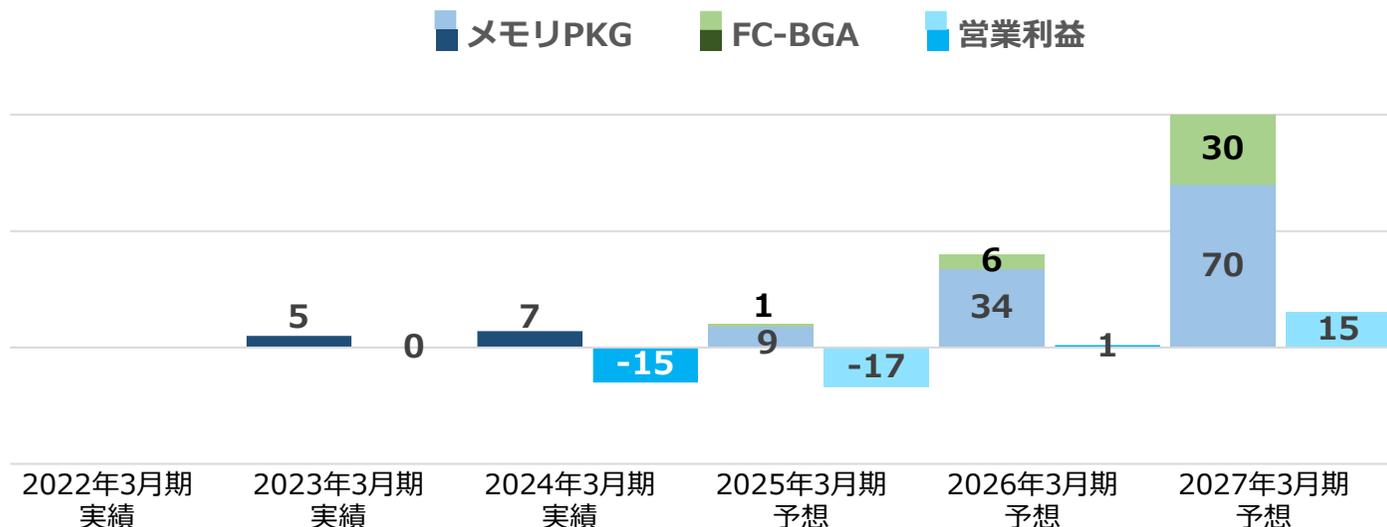


宮城県 石巻市

マイコーベトナム
第3工場



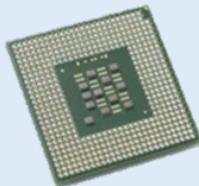
ベトナム ハノイ市



メモリパッケージが下期から立ち上がる

製品

● FC-BGA基板



特徴

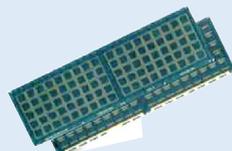
- SAP工法を活用したパッケージ基板
- L/S=12/12μm以下の超細線
- 高多層・PKGサイズ大型化対応

用途



民生・車載向け
ロジック半導体

● メモリパッケージ



特徴

- MSAPを活用したL/S=25/25um以下の微細配線対応
- 0.1mm以下の超極薄基板対応

用途

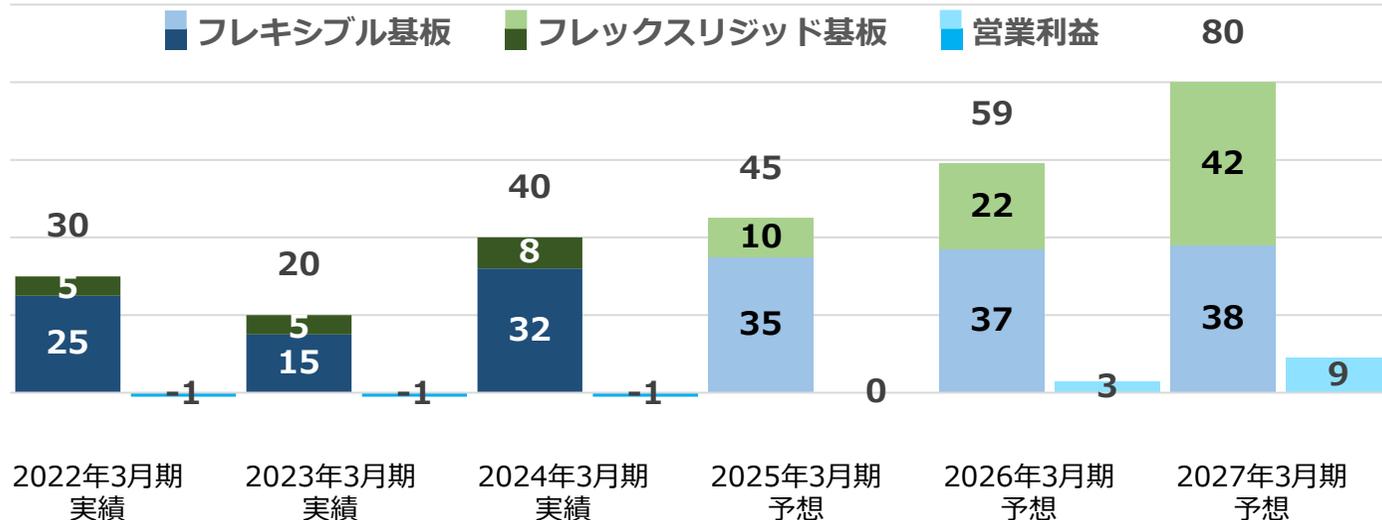


メモリPKG

新規事業の取組 フレキシブル基板

(単位：億円)

生産拠点



収益性が高いフレックスリジッド基板を拡大していく

製品

●フレキシブル基板



- ・片面
- ・両面
- ・多層



- 柔軟性による省スペース化
- 薄型、軽量化



●フレックスリジッド基板



- コネクターレス
- 省スペース化
- 高速伝送特性
- 実装効率



メカトロ/映像事業

1978年事業開始

メカトロニクス事業強化

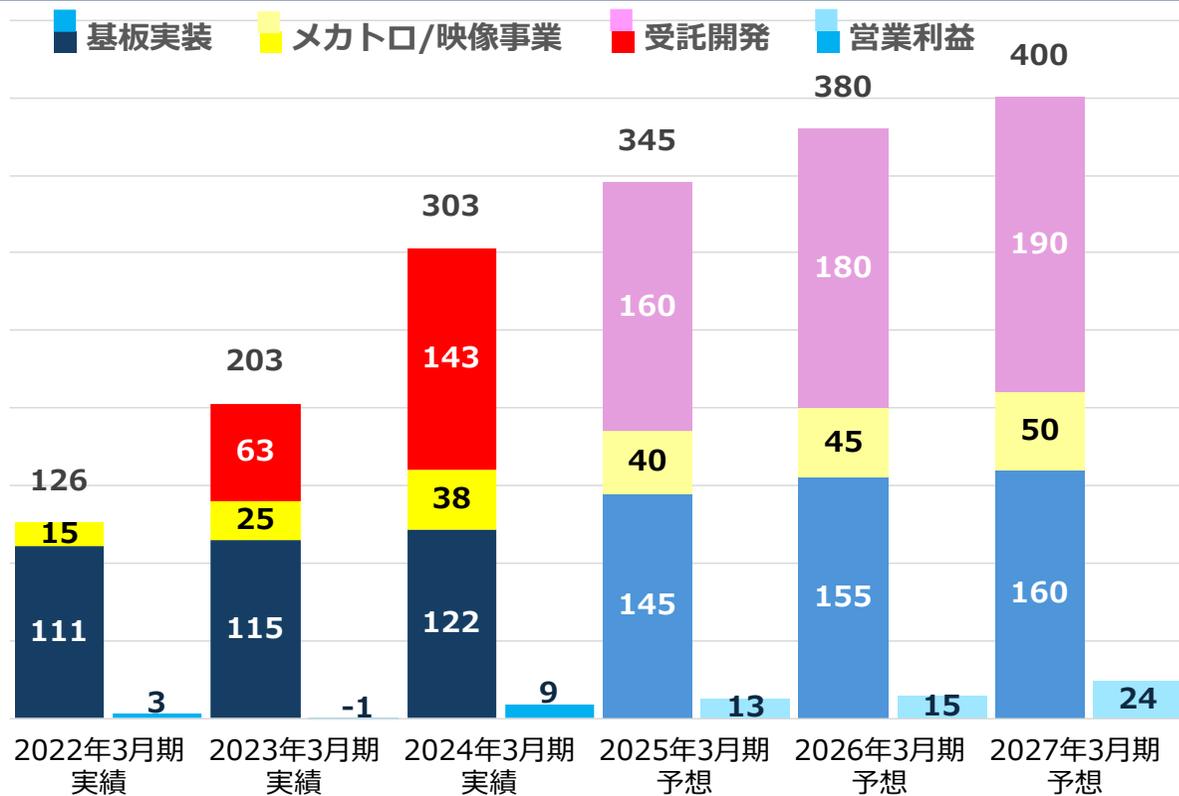
2019年09月メイコーオートメーションを設立

M&Aによる事業規模拡大

2019年10月トワダベトナム買収

M&Aによる開発体制強化

2022年10月NECエンベデットプロダクツ買収



今後の方針

受託開発と基板事業のコラボレーションによる
事業拡大と収益拡大

2023年3月期~2027年3月期
年平均成長率 33%

新規事業の取組 電子機器事業

メイコー本社



神奈川県 綾瀬市

■ 開発商品

- ・メカトロニクス
- ・FA機器
- ・映像機器

従業員数 51名

開発者 23名



メイコーエレクトロニクス マニファクチャラー



山形県 南陽市

クリーン環境での組立

SMTライン数 6ライン

組立エリア 2,000㎡

総点数 1億打点/月

従業員数 140名

メイコーエレクトロニクス ディベロップ



山形県 米沢市

■ 開発商品

- ・カメラモジュール
- ・無線モジュール
- ・液晶制御モジュール

従業員数 207名

開発者 75名



メイコーベトナム 第1工場



ベトナム ハノイ市

車載カメラモジュール
150,000台/月

SMTライン数 14ライン

組立エリア 2,500㎡

総点数 13億打点/月

従業員数 250名

メイコー オートメーション



ベトナム ハノイ市

■ 開発商品

- ・自律型AGV
- ・自動化設備

従業員数 120名

開発者 95名



メイコーハイズオン



ベトナム ハイズオン市

家電モジュール
通信モジュール
1,500,000台/月

SMTライン数 11ライン

組立エリア 2,900㎡

総点数 6億打点/月

従業員数 483名

開発拠点

生産拠点

Appendix

・商品区分の見直しについて 今後の販売戦略に合わせ、分類の見直しを行いました。

新区分	商品	旧区分
車載	旧区分から変更なし	車載
スマホ	スマホ	スマホ/タブレット
情報通信	衛星通信	衛星通信
	通信機器	AI家電/アミューズメント/産機他
	コンピューターおよび周辺機器	AI家電/アミューズメント/産機他
	タブレットPC	スマホ/タブレット
半導体PKG/モジュール	半導体PKG基板	半導体PKG
	モジュール基板	SSD/IoT
スマート家電/アミューズメント/産業他	AI家電をスマート家電に変更	AI家電/アミューズメント/産機他

・第1四半期商品別（新区分）

車載	230
スマートフォン	55
情報通信	28
半導体PKG基板	4
モジュール基板	34
アミューズメント、スマート家電、産業機器、その他	38
電子機器事業	81
合計	470